

民生证券股份有限公司
关于广州广合科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）



民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室）

二〇二〇年十二月

声明

本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

声明.....	1
目 录.....	2
第一节 发行人基本情况	3
一、发行人概况.....	3
二、发行人主营业务、核心技术和研发水平.....	3
三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.....	10
四、发行人存在的主要风险.....	10
第二节 本次证券发行基本情况	18
一、本次发行概况.....	18
二、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍.....	18
三、本保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明.....	19
第三节 保荐机构承诺事项	21
第四节 对本次证券发行的推荐意见	22
一、发行人关于本次证券发行的决策程序.....	22
二、针对发行人是否符合科创板定位所作出的专业判断以及相应理由和依据，保荐人的核查内容和核查过程.....	22
三、发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定.....	27
第五节 持续督导工作安排	30

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称	广州广合科技股份有限公司
英文名称	Delton Technology (Guangzhou) Inc.
注册资本	35,000 万元
法定代表人	肖红星
成立日期	2002 年 6 月 17 日
整体变更日期	2020 年 6 月 22 日
住所	广州保税区保盈南路 22 号
邮政编码	510730
电话号码	020-82211188
传真号码	020-82210929
互联网网址	http://www.delton.com.cn
电子信箱	stock@delton.com.cn
本次证券发行类型	首次公开发行股票并在科创板上市

二、发行人主营业务、核心技术和研发水平

(一) 发行人主营业务

公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，自成立以来主营业务没有发生变化。公司印制电路板产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠性等特点，市场布局覆盖“云、管、端”三大板块，产品广泛应用于服务器、消费电子、工业控制、通信、汽车电子、安防电子等领域，其中服务器用 PCB 产品的收入占比约 6 成，是公司产品最主要的下游应用领域，为全球大数据、云计算等产业提供重要电子元器件供应。

公司是国家高新技术企业，多年来在高精度、高密度和高可靠性印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验。公司拥有多项应用于各类服务器 PCB 板的核心技术，形成了自主知识产权，并掌握了与之配套的高精度制造工艺。公司自主研发的“新型 POFV+Dimm 超厚高速服务器板制造技术”应用于云计算高速服务器的 CPU 主板，在服务器 Dimm 内存位置采用 POFV 整平技术，并采用 UPI 传输技术处理 CPU 之间的信号通讯，实现对应阻抗 $\pm 8\%$ ，同时在板厚 3.0mm、微孔直径 0.2mm 的条件下可实现孔铜 25 μm 、面铜 48 μm 的成品要求，并可满足客户在翘曲度管

控、钻孔孔壁质量管控等方面的严苛要求，能够保证在高强度计算下信号传输的准确性、完整性；“新一代高速存储主板制造技术”应用于中高端储存类服务器主板，该技术克服了树脂流动度降低、材料刚性变高所带来的可加工性变差的问题，同时可以减少加工过程中插入损耗的影响，产品厚径比达到 12:1-14:1 之间，采用润滑降温微孔钻孔技术、复合波脉冲电镀技术提升高厚径比产品的孔壁质量，保证此类产品信息传输的可靠性。此外，公司还自主研发了“超高速服务器印制电路板制造技术”、“超大尺寸高速服务器电路板制造技术”、“高速服务器精密背钻技术”、“高密度互连阶梯服务器电路板制造技术”等多项应用于服务器板生产的核心技术，与上述核心技术相关的多项产品被认定为广东省高新技术产品。

公司根据自身技术特点和管理优势，结合下游市场的发展趋势制定了“云、管、端”发展战略。“云”是指与云计算相关的服务器用高速多层精密 PCB 产品，“管”是指作为数据交互管道的通信设备相关 PCB 产品，“端”则是指智能终端设备，即与消费电子、汽车电子、工控医疗等相关的 PCB 产品。公司在不断巩固“云”相关的服务器用 PCB 市场地位的同时，也积极拓展 5G 通信设备以及智能终端设备的 PCB 产品市场。公司将通过完善产品结构，优化技术能力布局，提高市场竞争力和盈利能力。

公司以客户为中心，为客户持续提供品质稳定的产品和高效的服务，已积累了一批优质的客户资源，主要客户包括浪潮信息、DELL（戴尔）、Foxconn（鸿海精密）、Quanta Computer（广达电脑）、Jabil（捷普）、HP（惠普）、Cal-Comp（泰金宝）、Celestica（天弘）、Inventec（英业达）、海康威视、Honeywell（霍尼韦尔）、Flex（伟创力）等。此外，公司已和华为、中兴、联想等国内知名客户开展合作，优质的客户资源为公司进一步发展奠定了良好基础。

根据中国电子电路行业协会的统计，2019 年公司在中国电子电路行业排行榜综合 PCB 企业排名中位列第 40 位，内资 PCB 企业排名中位列第 21 位。公司是中国内资 PCB 企业中排名第一的服务器 PCB 供应商，2016 年到 2019 年连续获得中国服务器市场占有率第一的浪潮颁发的“年度优秀供应商奖”；连续 11 个季度获得 DELL（戴尔）服务器 PCB 供应商评级第一名；2018 年荣获鸿海精密云端企业解决方案事业群颁发的“2017 年最佳策略供应商”奖，公司在服务器

PCB 市场树立起良好的品牌形象。

（二）核心技术

公司是国家高新技术企业，被认定为广东省高频高速印制线路板工程技术研究中心，通过长期的研究开发，公司已拥有多项核心技术，使用特定的机器设备为不同客户生产出不同要求的定制化产品；建立高度柔性化的生产机制，智能化快速产线切换，同时满足不同客户多样性的要求，快速响应客户；掌握高精度的制造工艺，可以同步满足客户设计需求；建立起完整、严格的工艺流程、品质管控体系，持续生产高品质、高可靠的产品；并通过与客户的深度合作，不断拓展特种电路板产品线如应用于服务器的产品线、新能源汽车的产品线、高密度互连的 HDI 产品线等，公司的核心技术具体情况如下：

序号	核心技术名称	技术来源	技术先进性及其特征
1	新型 POFV+Dimm 超厚高速服务器板制造技术	自主研发	该技术主要应用于多路服务器 CPU 主板, 其产品主要运用于当前云平台的高速计算。特征包括: 采用 Low Loss 材料; 采用 UPI 传输技术处理 CPU 之间的信号通讯, 实现对应的阻抗 $\pm 8\%$; PCB 板叠构不对称, 改善原内存模块的信号损失; 针对严苛的翘曲要求开发出对翘曲管控技术; 在铜厚要求 $48\ \mu\text{m}$ 、外层线路达成 $0.086\text{mm}/0.086\text{mm}$ 、板厚 3.0mm 、微孔直径 0.2mm 的条件下实现孔铜 $25\ \mu\text{m}$, 面铜 $48\ \mu\text{m}$ 的成品要求; 同时采用 POFV 工艺制作, 使得芯片的规格, 布线密度得到大幅提高。这类产品广泛用于互联网企业大计算力的 AI 服务器以及各种平台的高速服务器。
2	超高速服务器印制电路板制造技术	自主研发	该项技术主要面向的产品是稳定量产的云计算平台服务器产品。其特点是材料的插损等级高, 因此对材料的加工过程需要进行特别管控, 使用等离子技术进行加工。由于材料填料增加, 传统的高 Tg 环氧树脂材料被升级为改性环氧树脂, 树脂流动度降低, 材料的刚性变高, 压合及 PCB 的机械加工可加工性开始变差, 因此, 此类 PCB 加工需要特别注意对插入损耗的影响。同时, 为达到量产的主流产品对应的厚径比在 $10:1-12:1$ 之间, 该技术采取了背钻等多种加工工艺。这类服务器广泛应用于互联网企业、金融机构以及智慧城市系统当中。
3	新一代高速存储主板制造技术	自主研发	该项技术是针对当前存储器主板进行的研发技术攻关, 其主要面向的产品是稳定量产的云计算平台存储器产品。这类产品的特点是相对同一时代的服务器产品, 对材料的电性能及可靠性有更高要求, 同时板厚增加, 层数升高达到 18 层及以上。大容量的数据传输决定了产品需要采用更低损耗值的高速材料。在过程控制上, 公司攻克了影响插损的关键工艺及测试方法。同时, 为达到量产的主流产品对应的厚径比在 $12:1-14:1$ 之间, 该技术采用了背钻、精准阻抗控制, 热可靠性及老化的可靠性控制技术。这类产品广泛应用于互联网企业、金融机构及智慧城市的数据存储当中。
4	超大尺寸高速服务器电路板制造技术	自主研发	该项技术是为了当前存储器平台进行的研发技术攻关, 主要是为了应对当前爆发式增长的数据存储的需求, 技术研发的目的在于增加对应的存储阵列, 提升存储容量。此类产品技术特点是尺寸比较长, 从传统的 610mm 提升到了 680mm , 材料使用对应等级的高速材料, 传统的高 Tg 环氧树脂材料被升级为改性环氧树脂, 树脂流动度降低, 材料的刚性变高, 可加工性开始变差。同时研发出此类 PCB 加工因为线路板尺寸变长带来的阻抗、插损及尺

			寸变化的 PCB 加工工艺技术。
5	新一代高速存储领域服务器材料及制造工艺	自主研发	该技术包含对下一代高速材料的层压、钻孔、除胶等加工技术；通过对材料硬度的分析，通过 DOE 实验的方式获取对应的钻孔参数，从而实现这类材料的高可靠性孔壁质量的加工，获得小于 50 微米的晕圈的孔壁质量；通过等离子除胶等技术的应用以及对参数的不断测试，获得洁净的孔壁，从而避免了 ICD 等孔壁质量问题；通过对不同材料流动度、不同材料胶化含量、不同填胶类型等进行研究，达到这类产品在 12-24 层的层压的高品质加工，获得至少 D+10 的对准度能力，以及在内层使用 2oz 等厚铜的技术能力。此类 PCB 将是数据中心设备应用的主流产品。
6	高速服务器精密背钻技术	自主研发	该技术主要对图形对位技术、层间对位技术、钻孔对位技术等进行研究。研究图形对位技术，确保层间对位能够稳定维持在 2mil，特别在 BGA 位置能够维持在 1mil 的状态；研究层间对位技术，达到层间对准度的 D+10mil，BGA 位置 D+9mil 的状态。研究钻孔对位技术，最终实现一钻孔与背钻孔对准度在 2mil 的状态，从而实现在 BGA 区域有差分线的情况下仍然能够制造背钻，在单通道高达 16G 的传输速率下可减少 BGA 位置芯片的信号传输损耗。
7	高密度互连阶梯服务器电路板制造技术	自主研发	该技术通过对多阶 HDI 板技术、阶梯技术以及薄芯板加工技术等进行综合研究，实现二阶 HDI 盲孔、阶梯金手指以及 2mil 薄芯板在同一片高速 PCB 以内的成果，从而为高层数复杂 FPGA 产品提供了稳定可靠的 PCB。
8	高频测距天线板制造技术	自主研发	产品应用于 5G 场景，适用于各种测距的场合，对应的测试精准度较高，反应较快。采用的 PCB 方案为使用碳氢化合物材料进行这类产品的加工，其主要管控重点在材料的机械加工，确保孔壁质量在 IPC 的 C 级规范以内，同时满足孔铜在 25 μm 以上的要求。另外，外层线路均匀性方面，要求在表面处理后可以达到 $\pm 0.025\text{mm}$ 的线路公差且制程能力的 Cpk 稳定在 1.33 以上。
9	高端通讯铁氟龙板制造技术	自主研发	该技术针对通讯的高频产品，汽车智能驾驶的高频产品的 PCB 制作技术进行研究，包含对 PCB 的机加工，孔壁处理技术，阻焊等过程技术的加工研究，结合信号的影响因素的分析控制，实现采用铁氟龙材料的通讯类高频产品的高效加工。 通过对钻孔参数的选择，以及盖垫板的使用，提升该产品孔的质量；对活化过程参数的 DOE 实现较高的产品过孔镀铜质量，满足射频领域对孔的高可靠性要求。 调整外层阻焊前处理的流程，严格控制外层蚀刻后到阻焊的时间，并辅助活化以确保外层阻焊与材料表面的附着力，达到在户外使用的品质要求。采用在成型的时候调整成型参数，调整压力脚等参数，达到在成型过程中材料不拉丝或较少拉丝导致的毛刺现象。
10	汽车电子的散热层板制造技术	自主研发	该项技术是为了应对汽车内散热模块而开发的技术，主要特点为在线路板上覆盖一层高效散热层，从而对局部的元器件进行导热。散热层对应的厚度一致性要求比较高，在 70-90 微米的厚度范围内其 Cpk 需要稳定在 1.33 以上，对产线的均匀性提出比较高的要求，同时该技术的研发能够有效提升产出，提升效率，是一种低成本的 PCB 散热加工技术。
11	物联网半孔模块板制造技术	自主研发	该技术应用广泛，主要应用在模块类产品上，比如蓝牙无线模块，物联网的控制模块等无线模块，其技术特点为对应的半孔是通过钻孔以及成型两个 PCB 加工工艺完成的，钻孔对准度系统与成型对准度系统需要做比较好的匹配，并且在外层半孔对应的孔环设计，以及阻焊设计上需要做特殊处理。其半孔的孔径公差可控制在 $\pm 0.05\text{mm}$ ，最小半孔孔径可加工 0.35mm。
12	电路板制造过程中的信号完整性技术	自主研发	该技术主要是在印制电路板加工过程中对高速信号完整性的影响方面着手研究，主要目标为提升当前大数据服务器平台 PCB 的信号完整性。 通过对内层以及层压等表面微蚀状态的研究，得到高速信号在内层以及层压多次加工之后的信号损失；通过研究背钻残桩长度以及过孔孔环、线宽间距关系，得到残桩、线宽间距等因素对高速信号插入损耗的影响程度，并对上述因素进行管控，从而得到批量稳定合规的 PCB 信号传输损耗，为高速 PCB 板信号的稳定传输提供基础。

13	影响 ULL 材料电性能因素及解决方案技术	自主研发	该项技术是为了未来云计算平台服务器进行预研而开展的技术研发攻关，其主要面向的产品是在 2023 年以后量产的产品，这类产品的特点是采用信号表现较好的材料，同时也需要对此类产品的可制作性的研究、制作成本的优化研究，对材料的加工过程需要特别管控。ULL（超级低损耗）材料的技术特点是树脂体系及玻璃纤维都有所变化，材料的刚性变高，可加工性变差。因此，对材料在 PCB 加工过程中的因素进行识别，以确定影响到 PCB 加工后信号表现的主要因素，进而为未来三到五年的服务器设计，特别在材料选择以及 PCB 加工方面提供基础的参考，测试评价采取网络分析仪进行信号分析。
----	-----------------------	------	--

（三）研发水平

1、研发人员及研发成果情况

截至报告期末，公司共有研发及技术人员 548 人，其中，核心技术人员 5 人。公司核心技术人员均具有丰富的研发经验，先后为公司开发出新型 POFV+Dimm 超厚高速服务器板制造技术、超高速服务器印制电路板制造技术、新一代高速存储主板制造技术等核心技术。截至招股说明书签署日，核心技术人员作为发明人已成功为公司取得 22 项专利。

公司核心技术人员简历如下：

黎钦源先生：副总经理、总工程师。1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，化学工程专业，本科学历。历任东莞生益电子有限公司制作工艺助工、工程师、主任工程师、经理、高级经理，广州杰赛科技股份有限公司技术总监。2013 年 1 月加入公司，现任公司副总经理兼总工程师。

黄金广先生：监事会主席、品质总监。1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，工程管理专业，本科学历。历任东莞红板多层线路板有限公司工程师，东莞生益电子有限公司主任工程师，依利安达（广州）电子有限公司品质工程经理，广东世运电路科技股份有限公司品质总监。2018 年 9 月加入公司，现任公司品质总监、监事会主席。

黄杨先生：设备总监。1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于威尔士大学，MBA 专业，研究生学历。历任珠海松下马达有限公司主管，珠海方正印刷电路板发展有限公司设备经理，重庆方正高密电子有限公司设备经理。2018 年 10 月加入公司，现任公司设备总监。

彭镜辉先生：职工代表监事、研发经理。1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，化学工程与工艺专业，本科学历。历任东莞生益电子有限公司工程师，广合有限工艺工程师、高级工程师、主任工程师，广州添利电子科技有限公司高级工程师。2015年12月加入公司，现任公司研发经理、监事。

钟冠祺先生：设备高级经理。1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，化工设备与机械专业，本科学历。历任东莞生益电子有限公司设备部经理，江门崇达电路技术有限公司设备部经理。2017年9月加入公司，现任公司设备高级经理。

2、在研项目情况

截至报告期期末，发行人主要在研项目如下：

序号	项目名称	技术来源	主要研发内容	拟达到的技术目标	进展情况
1	16G 板材材料研发	自主研发	针对 16G 服务器材料进行测试，针对下一代 Eagle Stream 平台 PCIe Gen5 16GHz 产品设计，客户初步确定服务器主板使用 Ultra Low Loss 材料，电性能要求目标为 0.96dB/inch@16GHz。	1、Tg/ Δ Tg 满足规格要求； 2、Z-CTETg 前 (ppm/ $^{\circ}$ C) \leq 60ppm/ $^{\circ}$ C； 3、Tg 后 (ppm/ $^{\circ}$ C) \leq 300ppm/ $^{\circ}$ C； 4、(50-260 $^{\circ}$ C)% \leq 3.5%； 5、T260(min) \geq 30min； 6、T288(min) \geq 15min； 7、热应力测试 6 次热应力漂锡，孔壁间距 8mil/12mil/16mil/20mil 孔无分层； 8、孔壁质量孔粗 \leq 1.0mil、灯芯 \leq 3mil、钉头小于 1.5 倍、晕圈 \leq 4mil； 9、CAF260 度回流 6 次，85 $^{\circ}$ C/85%RH, 100V, 500 小时，R \geq 100M Ω ； 10、IST260 度回流 6 次，测试 500 循环导通电阻值测试前后变化率小于 10%； 11、DK 及 DF 按供应商资料，并反推 DK&DF； 12、Loss 测试需满足对应材料等级 Loss 要求。	研究测试阶段
2	大尺寸 AAU 背板制作技术	自主研发	1、针对 AOI、钻孔、成型等工序，由于机台台面尺寸不足，采用切割资料的办法进行测试生产； 2、针对板弯翘要求高（以及存在不对称结构）、背钻所需板厚公差好，测试优化的专用压合程式及管控方法；	1、对内层、层压、钻孔、成型等工序进行设备调整及工装优化，并对其工艺稳定性及制作参数进行优化，从而达到制造 800mm 尺寸大板的能力； 2、提升电镀制程能力。目前孔径 0.25mm，厚径比 11.6，需要达到 90%以上的批量能力； 3、树脂塞孔能力提升。主要表现为树脂塞孔导致油墨连片，研磨困难（研磨次数约 5~7 次，也有电镀面铜不均的孔口位置低洼导致），且容易导致	小批量生产阶段

序号	项目名称	技术来源	主要研发内容	拟达到的技术目标	进展情况
			3、测试孔数大于 10 万/panel 的树脂塞孔，品质控制能力及摸索控制方法。	大孔孔口面铜偏薄的品质问题，需要研究并控制孔口铜厚维持在 25 μm 以内的控制水平； 4、板材介厚均匀性。可能需要通过提高温升速率、降低压力等方式达到； 5、针对量产的治具需按大尺寸板增购，包含如内层隔板胶片、无尘室基板放板车架、外层板转移车架、烘烤车架、成型后的放板架、回流焊后的冷却放板架等。	
3	三面包金金手指工艺研究	自主研发	研究使用背钻以及蚀刻两大技术，实现金手指镀金的时候不在金手指位置拉引线，从而实现金手指三面包金的状态。	1、金手指镀金后背钻技术，包括对应的 Stub 能力的控制等； 2、金手指镀金后蚀刻技术，需要搭配选择性镀金湿膜，阻焊湿膜等技术实现高可靠性蚀刻，并通过蚀刻减少表面信号残桩，确保高速信号的高质量传输； 3、实现三面包金的金手指状态，大大降低连接器插拔的损坏率。	研究测试阶段
4	EGS 平台主材不同结构及铜箔的性能研究	自主研发	本项目旨在通过研究 EGS 平台服务器主材在不同的信号结构下面，以及搭配不同的铜箔以及玻璃布之下的信号损耗差异，从而得到较为经济而且稳定可靠的信号传输介质结构。	1、研究 EGS 平台中使用 Ultra Low loss 等级的材料，在 HTE 和 HG310 两种不同外层铜箔下 loss 变化； 2、研究在 HVLP 和 RTF RG311 两种不同铜箔下内层 loss 变化； 3、研究两种铜箔下 3/6、4/5、6/6 三种叠构 1/HOZLoss 变化； 4、研究 EGS 平台中使用 Ultra Low loss 等级的材料，在 3/9、4/5、3/6、4/4、6/6 五种不同叠构下 loss 变化。	研究测试阶段
5	14 层不对称结构产品研发	自主研发	本项目旨在通过对高速材料的不对称结构进行研究，使用不同的 PP 搭配，以达到在不对称结构下面的板面翘曲达到客户 PCBA 贴装的要求。	1、研究不同 PP 的搭配对翘曲的影响； 2、研究不同压合程序对翘曲的影响； 3、研究压合后过程对 PCB 的翘曲的影响； 4、目标为达到 400*400mm 范围的 PCB，翘曲在 0.3% 以内的品质要求。	量产阶段
6	Low Profile 棕化药水研究	自主研发	本项目旨在对于 EGS 平台服务器的主板，寻找低成本的材料及 PCB 方案。	1、研究低粗糙度棕化对不同等级材料的可靠性及电性能影响； 2、目标为在使用低粗糙度棕化药水的前提下可以达到 0.96db/inch 的信号损耗要求。	小批量生产阶段
7	18 层板+树脂塞孔新产品技术研究	自主研发	研究在 18 层结构下实现树脂塞孔，背钻高对准度能力的需求。	1、实现背钻对准度 D+8 的要求； 2、层偏对准度在 D+9； 3、实现 0.5mm pitch 的高可靠性密集阵列孔加工。	研究测试阶段
8	四压三阶 HDI 分	自主研发	本项目所包含技术有四压三阶 HDI 的加工技术以及对应的	1、实现线宽/间距 2.0/2.5mil 的产品品质要求； 2、HDI 对准度控制在 2mil 以内；	小批量生

序号	项目名称	技术来源	主要研发内容	拟达到的技术目标	进展情况
	级分段金手指研发		外层分级分段金手指技术，以实现类似光模块传输的信号走线结构以及功能。	3、分级分段金手指公差控制在±1mil 以内。	产阶段
9	小间距阻抗工艺技术的研究	自主研发	针对越来越小的线宽间距搭配，需要研发在超高速材料搭配下，如何能够达到小线宽间距下的差分阻抗要求。	1、实现 3.5/3.5mil 下阻抗 85±8% 的目标； 2、批量良率达到 99% 以上。	中试阶段

三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标

项目	2020年1-6月 /2020.6.30	2019年 /2019.12.31	2018年 /2018.12.31	2017年 /2017.12.31
资产总额（万元）	171,410.23	133,377.53	130,622.18	71,441.36
归属于母公司的所有者权益（万元）	73,084.05	60,782.57	48,869.89	21,908.53
资产负债率（母公司）	53.56%	52.55%	62.59%	69.33%
营业收入（万元）	78,289.87	134,276.57	103,132.15	74,644.60
净利润（万元）	9,178.48	7,672.95	6,619.10	3,301.01
归属于母公司所有者的净利润（万元）	9,178.48	7,672.95	6,619.10	3,301.01
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	9,099.38	11,571.27	8,437.37	4,018.85
加权平均净资产收益率	13.82%	14.20%	20.96%	16.96%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	8,469.34	26,248.21	21,815.62	3,669.29
研发投入占营业收入的比例	4.62%	4.67%	4.84%	3.75%

四、发行人存在的主要风险

发行人存在的主要风险如下：

（一）技术风险

1、技术研发及应用风险

随着 PCB 行业竞争逐渐激烈以及行业的发展，技术能力成为企业能否在长期的竞争中取得优势的重要因素。一方面，产品的技术含量是下游客户选择供应商的重要标准；另一方面，产品的技术含量也影响企业自身的盈利能力。

若公司不能紧跟 PCB 市场未来发展方向，或存在技术研发失败、技术未能实现产业化情形，将可能对公司的经营业绩带来不利影响。

2、核心技术人员流失的风险

PCB 行业对生产科技属性要求较高，不仅需要具备对产品结构、制造工艺进行深入研究和创新开发的能力，以帮助客户快速完成新产品开发、抢占市场先机，还需要具备满足客户优化产品的设计布局、提升产品稳定性需求的能力。因此，PCB 企业必须拥有大量的高素质综合型人才。

综合型专业人才的培育往往需要经过大量的知识体系训练和长期的行业经验积累，耗时较长。若未来核心技术人员大面积流失，公司生产经营尤其是新产品研发将受到较大的影响。

(二) 经营风险

1、宏观经济及下游市场需求波动带来的风险

印制电路板是电子产品关键电子互连件，其发展与下游行业联系密切，与全球宏观经济形势相关性较大。宏观经济波动对 PCB 下游行业将产生不同程度的影响，进而影响 PCB 行业的需求。

受金融危机影响，2009 年 PCB 行业经历寒冬，根据 Prismark 统计，2009 年全球总产值同比下降 14.7%；随着各国对金融危机的积极应对，各国政府陆续出台刺激经济发展的政策和措施，全球经济逐步复苏，PCB 产值迅速恢复，2010 年全球市场规模达到 524.7 亿美元，同比增长 27.3%；近年来，随着全球经济增速放缓，PCB 行业全球总产值增速较为平稳。可见，若宏观经济向好，下游行业景气程度较高时，印制电路板得到较好的发展；反之，若未来全球经济增速放缓甚至迟滞，印制电路板行业发展速度将放缓或陷入下滑，对公司的业务发展及营业收入增长产生负面影响。

2、市场竞争加剧的风险

全球印制线路板行业集中度不高，生产商众多，市场竞争充分。2019 年全球排名第一的 ZD Tech(臻鼎)销售金额为 38.89 亿美元，市场占有率约为 6.34%，

而全球排名前十的 PCB 厂商合计市场占有率为 35.70%。与全球 PCB 行业相似，我国 PCB 行业市场竞争激烈。根据中国电子电路行业协会的统计数据，2019 年中国 PCB 产值排名第一的鹏鼎控股（深圳）股份有限公司，营业收入为 266.15 亿元，市场份额约为 11.71%，排名前十的厂商合计市场份额约为 48.75%。在服务器 PCB 领域，公司主要竞争对手包括健鼎科技、金像电子、深南电路、沪电股份、生益电子及胜宏科技等企业，上述企业具备较强的资金及研发实力。

受云计算、5G、AI、VR/AR 等下游应用领域需求影响，国内服务器 PCB 行业的规模和企业数量均有所增长，若公司未能持续提高自身技术水平、生产管理、产品质量以应对市场竞争，可能会在市场竞争中处于不利地位，公司存在因市场竞争导致经营业绩下滑的风险。

3、下游应用领域集中风险

目前，公司生产的 PCB 主要应用于服务器、消费电子、工业控制、通信、汽车电子、安防电子等领域，其中服务器领域占比较高。报告期内，公司服务器领域收入占当期主营业务收入比例为 48.84%、53.90%、59.48%和 66.74%，占比逐渐提升。

PCB 是服务器的重要原材料之一，若未来下游服务器行业发生波动，且对 PCB 需求发生不利变化，可能对发行人业务发展产生不利影响。

4、客户集中的风险

公司下游行业企业主要为规模较大的电子产品制造商，包括终端客户及 EMS 公司（电子制造服务商），如浪潮信息、戴尔、鸿海精密、广达电脑、捷普等。报告期，公司前五大客户销售额占同期主营业务收入的比例分别为 67.13%、64.54%、66.51%和 70.51%，客户相对集中。若公司因产品和服务质量不符合主要客户要求导致双方合作关系发生重大不利变化，或主要客户未来因经营状况恶化导致对公司的订单需求大幅下滑，均将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

5、原材料价格波动风险

公司原材料占主营业务成本的比例较高，报告期平均约为 59.61%。公司生

产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜球、铜箔、金盐、干膜等，上述主要原材料价格受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品的影响较大。

未来若原材料价格出现大幅波动，公司不能采取措施将原材料上涨的压力转移或者通过新产品、技术创新来抵消原材料价格上涨的压力，又或者在原材料价格下跌趋势中未能做好存货管理，公司的经营业绩将受到不利影响。

6、贸易摩擦风险

公司产品以外销为主，报告期，公司外销收入占主营业务收入的比例分别为 53.61%、64.91%、71.38%及 71.72%。公司外销主要以境内保税园区或保税工厂、中国香港为主，抵达香港的货物中又有较大比例流向客户的中国境内工厂，因此，公司外销产品大部分在中国大陆继续组装加工，小部分出口至亚洲其他国家及地区、欧洲、美洲。

如果因国际贸易摩擦而导致相关国家对我国 PCB 产品采取限制政策、提高关税及采取其他方面的贸易保护主义措施，将会对我国 PCB 行业造成一定冲击，从而可能对公司的业务发展产生不利影响。

（三）财务风险

1、应收账款余额较大风险

最近三年末，公司应收账款余额分别为 37,329.06 万元、41,642.98 万元、49,676.22 万元，占当期营业收入比例分别为 50.01%、40.38%、37.00%。最近三年，应收账款周转率分别为 2.49 次、2.61 次、2.94 次。如果下游客户遭遇财务状况恶化、经营危机或公司应收账款管理不善，公司应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账，将会影响公司的资金周转，对公司业绩和生产经营也将产生不利影响。

2、所得税优惠政策变化的风险

2017 年 12 月 11 日，公司被认定为高新技术企业，取得了 GR201744008378 号《高新技术企业证书》，证书有效期三年，公司 2017 年、2018 年、2019 年减按 15%缴纳企业所得税。公司《高新技术企业证书》于 2020 年 12 月到期，目前正在进行高新技术企业资格重新认定。

如果有关高新技术企业税收优惠政策发生变化，或公司不再具备享受上述优惠政策的条件，使得公司不能继续享受 15%的优惠所得税税率，公司的所得税费用将上升，盈利水平将受到不利影响。

3、出口退税政策变化的风险

公司所属行业为国家鼓励出口类行业，因此出口货物享受增值税“免、抵、退”税收优惠政策。2017年-2018年4月，公司出口产品的退税率为17%，根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），自2018年5月1日起，原适用17%税率且出口退税率为17%的出口货物，出口退税率调整至16%。根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日起，原适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物劳务，出口退税率调整为13%。

报告期，公司销售产品的征税率和出口退税率一致且同步下调，出口退税率的变动不影响公司损益。但如果未来在公司销售产品的征税率不变情况下，公司产品的出口退税率下调，将对公司盈利水平产生不利影响。

4、汇率波动的风险

报告期内，公司外销收入占当期主营业务收入的比例分别为53.61%、64.91%、71.38%及71.72%，公司外销产品主要以美元等货币计价。报告期内，公司汇兑收益分别为-820.07万元、-14.28万元、670.09万元及526.07万元，占当期利润总额的比例分别为-19.47%、-0.19%、7.30%及5.02%。

若未来人民币出现大幅升值，一方面会导致公司汇兑损失增加，另一方面相对国外竞争对手的价格优势可能被减弱，假设在外币销售价格不变的情况下，以人民币折算的销售收入减少，可能对公司经营业绩造成不利影响。

（四）法律风险

1、环保风险

公司生产过程涉及到蚀刻、电镀等工序，会产生废水、废气及固体废物等污染物和噪声。

若发生因管理疏忽或者不可抗力事件导致出现的环保事故，可能会给公司周围环境造成污染及触犯环保相关的法规，对公司经营造成不利影响。

另外，随着大众环保意识的增强，政府对环境保护的关注度也在增加，不排除环保部门进一步提高对相关企业的环保要求，使公司加大环保设施及运营投入，增加环保成本，可能对公司经营业绩造成不利影响。

2、明股实债安排对黄石广合股权结构稳定性的风险

2020年1月，长江黄石基金与黄石广合、发行人、肖红星、刘锦婵签署《黄石广合精密电路有限公司增资协议》和《黄石广合精密电路有限公司增资协议之补充协议》，约定由长江黄石基金向黄石广合增资19,600万元，发行人向黄石广合增资400万元。增资完成后，发行人持有黄石广合51%股权，长江黄石基金持有黄石广合49%股权。发行人将其持有的黄石广合51%股权全部质押给长江黄石基金，发行人实际控制人肖红星、刘锦婵承担连带责任保证。

2020年9月，长江黄石基金与黄石广合、发行人、肖红星、刘锦婵签署《黄石广合精密电路有限公司增资协议之补充协议二》，明确长江黄石基金向黄石广合提供的1.96亿元增资款为明股实债，长江黄石基金对黄石广合增资后，不承担股东责任，不派董事、监事及高级管理人员，不参与黄石广合的日常经营管理，不参与黄石广合的决策，且不承担黄石广合的亏损责任。长江黄石基金对黄石广合投资仅收取固定收益。同时约定办理黄石广合51%股权的解除质押手续。截至招股说明书签署日，黄石广合51%股权的解除质押手续已办理完成。

若发行人、黄石广合未能按照约定向长江黄石基金支付固定回报及偿还本金，则存在融资到期后发行人无法收回长江黄石基金所持有的黄石广合49%股权的风险。

（五）发行失败风险

如公司本次首次公开发行股票顺利通过上海证券交易所审核并取得证监会注册批复文件，将启动后续发行工作。公开发行时宏观经济环境、国内资本市场行情、公司业绩以及投资者对公司未来股价走势判断等因素都将对发行人本次发行产生一定影响。发行时如存在预计发行后总市值不满足招股说明书中选

择的市值标准，或存在首次公开发行股票网下投资者申购数量低于网下初始发行量等其他《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》中规定的中止发行的情形，发行人将面临发行失败的风险。

（六）存在累计未弥补亏损的风险

由于公司早期经营管理不善，同时 2016 年-2019 年期间公司给予员工股权激励，相应确认股份支付费用金额较大，导致累计亏损较大。截至报告期期末，公司合并报表的未分配利润为-10,080.12 万元，仍存在未弥补亏损。若公司无法完全弥补以前年度的累计亏损，存在短期内无法向股东进行利润分配的风险，将对股东的投资收益造成一定程度的不利影响。

（七）募集资金投资项目的风险

1、募集资金投资项目实施风险

公司本次募集资金主要用于“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第一阶段工程”，募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对技术发展趋势的判断等因素作出的。在公司募集资金投资项目实施过程中，公司可能面临市场变化、公司组织管理和市场营销的执行情况未及预期、遭遇突发性事件等不确定因素，导致项目未能按计划正常实施，影响项目投资收益和公司经营业绩。

2、固定资产折旧增加的风险

本次募集资金投资项目将主要用于固定资产投资，固定资产的大幅增加将导致折旧费用的增加。如果市场环境发生重大不利变化，公司募投项目产生的收入未实现既定目标，则公司将面临固定资产折旧费用增加而导致公司盈利能力下降的风险。

（八）新冠肺炎疫情引发的经营风险

由于新冠疫情持续时间和秋冬季节是否会发生反复存在不确定性，若疫情出现反复或再次恶化，各地政府采取封闭隔离、交通管制、停工停产等防疫管控措施，可能影响公司的正常生产，进而对公司生产经营、财务状况和持续经

营能力造成不利影响。

第二节 本次证券发行基本情况

一、本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	本次发行的股票数量不超过 10,000 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且不低于本次发行完成后股份总数的 10%。如果本次发行采用超额配售选择权的，则行使超额配售选择权而发行的股票为本次发行的一部分，本次发行股票的数量应当根据超额配售选择权的行使结果相应增加，且超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%，本次发行仅限公司公开发行新股，不包括公司股东转让股份。股东大会授权董事会可根据具体情况调整发行数量，最终以中国证券监督管理委员会同意注册的发行数量为准
发行方式	采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会及上海证券交易所认可的其他方式，包括且不限于向战略投资者配售股票
每股面值	人民币 1.00 元
发行后总股本	不超过 45,000 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）
拟上市证券交易所	上海证券交易所
拟上市板块	科创板
保荐人（主承销商）	民生证券股份有限公司
发行股票类型	人民币普通股（A股）

二、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

（一）保荐机构名称

民生证券股份有限公司

（二）本保荐机构指定保荐代表人情况

1、保荐代表人姓名

姜涛、王嘉

2、保荐代表人保荐业务执业情况

姜涛：保荐代表人，2011 年开始从事投资银行工作，曾参与王子新材 IPO、

兴蓉投资配股、金轮股份 IPO、景旺电子 IPO、盛弘股份 IPO、广东骏亚 IPO、兴森科技 2020 年可转债等项目，以及多家公司的改制辅导工作，具有丰富的投资银行业务经验。

王嘉：保荐代表人，2008 年开始从事投资银行工作，曾主持和参与了兴森科技 IPO、青松建化配股、兴蓉投资非公开发行、兴蓉投资配股、王子新材 IPO、景旺电子 IPO、盛弘股份 IPO、景旺电子 2018 年可转债、景旺电子 2020 年可转债等项目，以及多家公司的改制辅导工作，具有丰富的投资银行业务经验。

（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：孟子淇

其他项目组成员：曹显达、谢超

三、本保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明

（一）本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

截至本上市保荐书签署日，本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况

截至本上市保荐书签署日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情形。

（三）本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况

截至本上市保荐书签署日，本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，

以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

（四）本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

截至本上市保荐书签署日，本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系

截至本上市保荐书签署日，本保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

第三节 保荐机构承诺事项

（一）本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序；

（二）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关证券发行并上市的相关规定；

（三）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（四）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（五）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与其他证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（六）保证保荐代表人及项目组其他成员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（七）上市保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（八）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（九）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

（十）中国证监会规定的其他事项。

第四节 对本次证券发行的推荐意见

一、发行人关于本次证券发行的决策程序

（一）董事会决策程序

发行人已于2020年9月14日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案，并提请股东大会批准。

（二）股东大会决策程序

2020年9月30日，发行人召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。经核查上述股东大会的会议通知、议案、表决票、决议及会议记录等会议资料，本次股东大会在召集、召开方式、议事程序及表决方式等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

综上，本保荐人认为，发行人本次发行已获得了必要的批准和授权，履行了必要的决策程序，决策程序合法有效。

二、针对发行人是否符合科创板定位所作出的专业判断以及相应理由和依据，保荐人的核查内容和核查过程

（一）发行人符合科创板行业领域的核查情况

1、公司所属行业

公司主营业务为印制电路板的研发、生产与销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“398 电子元件及电子专用材料制造”之“3982 电子电路制造”。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“制造业”之“计算机、通信和其他电子设备制造业（代码C39）”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“1. 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1

新型电子元器件及设备制造”。

2、核查程序

针对公司的行业定位，保荐机构履行了如下核查程序：

（1）查阅了《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号）等权威产业分类目录、规定或指南；

（2）查阅了公司与相关客户的销售合同、销售订单等，对公司产品分类进行了复核审验；

（3）对报告期内主要客户进行了走访核查，走访核查的内容包含确认公司与客户交易的内容、客户下游领域等情况；

（4）查阅了同行业可比公司的相关公告文件中的行业分类。

3、核查意见

经核查，保荐机构认为公司主营业务与所属行业领域归类匹配，与同行业可比公司行业领域归类不存在显著差异。

（二）发行人符合科创属性要求的核查情况

1、研发投入核查

（1）研发投入具体情况

报告期，公司研发投入未进行资本化，研发费用具体情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
研发费用	3,614.61	6,265.07	4,992.31	2,800.47
营业收入	78,289.87	134,276.57	103,132.15	74,644.60
研发费用占营业收入比例	4.62%	4.67%	4.84%	3.75%

最近三年，公司累计研发投入14,057.85万元，累计占营业收入的比重为4.50%。

(2) 核查过程

针对公司的研发投入归集等情况，保荐机构履行了如下核查程序：

查阅了公司研发费用明细，查验了相关研发费用的原始凭证。获取了研发人员工资表、研发领料清单、固定资产及无形资产折旧摊销明细表。查阅了报告期研发项目的立项文件、结项文件等。访谈了公司研发人员及财务人员。确认了公司研发投入归集符合会计准则要求的情形。

(3) 核查结论

公司最近三年累计研发投入金额符合《暂行规定》第四条第一款：“最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例5%以上，或者最近3年研发投入金额累计在6,000万元以上；其中，软件企业最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例10%以上”。

经核查，保荐机构认为公司最近三年累计研发投入及占最近三年累计营业收入的比例真实、准确。

2、专利核查

(1) 公司专利具体情况

截至本上市保荐书签署日，公司已取得发明专利8项，并通过应用于产品制造和销售形成主营业务收入，具体如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日期	期限	专利权人	取得方式
1	一种低酸型酸性蚀刻再生剂及其酸性蚀刻母液	ZL201210126971.1	发明专利	2012.04.27	20年	广合科技	受让取得
2	一种PCB上BGA位置的背钻孔制作方法	ZL201610291974.9	发明专利	2016.05.05	20年	广合科技	原始取得
3	一种PCB线路板预防真空蚀刻线线路狗牙加工方法	ZL201610292251.0	发明专利	2016.05.05	20年	广合科技	原始取得
4	一种防铣镀槽毛刺及降低铣刀磨损加工方法	ZL201610292252.5	发明专利	2016.05.05	20年	广合科技	原始取得
5	一种PCB防断板铣镀槽及其应用方法	ZL201610291976.8	发明专利	2016.05.05	20年	广合科技	原始取得
6	一种PCB板钻孔高效防呆的加工方法	ZL201710849211.6	发明专利	2017.09.20	20年	广合科技	原始取得
7	一种基于二维码的菲林追溯管理系	ZL201710849230.9	发明专利	2017.09.20	20年	广合科技	原始取得

	统及方法						
8	一种挠性电路板精细线路的制作方法	ZL201811004147.2	发明专利	2018.08.30	20年	广合科技	原始取得

(2) 核查过程

针对公司的发明专利归属、有效期限、权利受限或诉讼纠纷情况及在主要产品（服务）中的应用情况，保荐机构履行了如下程序：

①核查了公司发明专利证书，确认了公司发明专利的归属及有效期限；

②查询并检索了国家知识产权局中国及多国专利审查信息查询系统（<http://cpquery.sipo.gov.cn/>），确认了公司发明专利的归属、有效期限、法律状态及权利受限情况；

③向国家知识产权局申请了专利登记情况查询，国家知识产权局出具证明确认了公司所拥有的专利情况；

④核查了公司的银行借款合同、担保合同等，确认了公司所拥有的专利未设置质押等他项权利；

⑤查询并检索了中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>），确认了公司该等专利不涉及诉讼纠纷。

(3) 核查结论

公司形成主营业务收入的发明专利数量符合《暂行规定》第四条第二款：“形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）5项以上，软件企业除外。”

经核查，保荐机构认为公司形成主营业务收入的发明专利数量真实、准确。

3、收入核查

(1) 公司报告期收入情况

报告期，公司营业收入情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
营业收入	78,289.87	134,276.57	103,132.15	74,644.60

最近三年，公司营业收入复合增长率为 34.12%，最近一年收入为 134,276.57 万元。

（2）核查过程

针对公司的营业收入情况，保荐机构履行了如下核查程序：

①通过查询国家企业信用信息公示系统、客户公司网站获取了公司主要客户包含股东信息的工商档案资料或资信报告资料，查阅上市公司客户公开信息，对其设立时间、经营范围、注册资本规模、股东构成、董监高人员情况等进行了比对核查；

②对报告期内主要客户进行了走访核查，走访核查的内容包含确认客户真实存在性、交易真实性以及与客户是否存在关联关系或其他利益安排等情况；

③对报告期公司主要客户进行函证。函证的内容包括报告期各期的交易发生额、应收账款余额，确认了销售交易金额以及应收账款的真实性与准确性；

④对报告期公司的收入进行了循环测试，确认了公司收入确认及时准确，未出现提前确认收入的情形。

（3）核查结论

公司最近三年营业收入复合增长率、最近一年营业收入金额符合《暂行规定》第四条第三款：“最近 3 年营业收入复合增长率达到 20%，或者最近一年营业收入金额达到 3 亿元。采用《审核规则》第二十二条第二款第（五）项上市标准申报科创板发行上市的公司除外。”

经核查，保荐机构认为公司营业收入金额及增长率真实、准确。

三、发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定

（一）本次发行申请符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条的规定

1、公司符合中国证监会《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）规定的发行条件

（1）本次发行申请符合《注册办法》第十条的规定

公司系由广合科技（广州）有限公司整体变更设立的股份有限公司。2020年6月22日，公司就本次整体变更事宜在广州市黄埔区市场监督管理局办理完成工商变更登记，并换发了统一社会信用代码为 91440116739749431N 的《营业执照》，注册资本为 35,000 万元。公司依法设立并持续经营时间已超过三年，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

（2）本次发行申请符合《注册办法》第十一条的规定

公司会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。报告期，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《审计报告》。

公司内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留结论的《内部控制鉴证报告》。

（3）本次发行申请符合《注册办法》第十二条的规定

①发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

②发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近两年内

主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近两年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

③发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

(4) 本次发行申请符合《注册办法》第十三条的规定

①发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。

②根据主管部门出具的合规证明、公安部门派出机构出具的无犯罪记录证明，最近3年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

③根据公安部门派出机构出具的无犯罪记录证明并经保荐机构核查，发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

2、公司股本结构符合在科创板上市要求

发行人本次发行股份不超过10,000万股人民币普通股，不涉及股东公开发售股份。本次公开发行后公司总股本不超过45,000万股，本次公开发行的股份数量不低于公司发行后股本总额的10%。

(二) 本次发行申请符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的规定

1、发行人选择的具体上市标准为：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

公司 2018 年、2019 年归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）分别为 6,619.10 万元、7,672.95 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000 万元。结合公司最近一次外部股权融资情况、可比公司估值情况，公司预计能够满足该项上市标准。

2、发行人不属于红筹企业，不存在表决权差异安排。

第五节 持续督导工作安排

事项	工作安排
(一) 持续督导事项	在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后三个完整会计年度内对发行人进行持续督导。
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度	强化发行人严格执行中国证监会有关规定的意识，协助发行人制作、执行有关制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，确保保荐机构对发行人关联交易事项的知情权，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
2、督导发行人有效执行并完善防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	协助和督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督导发行人尽可能避免和减少关联交易，若关联交易为发行人日常经营所必需或者无法避免，督导发行人按照《公司章程》等规定执行，对重大的关联交易本保荐机构将按照公平、独立的原则发表意见。
4、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	与发行人建立经常性信息沟通机制，督导发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定，适时审阅发行人信息披露文件。
5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项	建立与发行人信息沟通渠道、根据募集资金专用账户的管理协议落实监督措施、定期对项目进展情况进行跟踪和督促。
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	严格按照中国证监会有关文件的要求规范发行人担保行为的决策程序，要求发行人对所有担保行为与保荐机构进行事前沟通。
7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心技术以及财务状况	与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信息。
8、根据监管规定，在必要时对发行人进行现场检查	定期或不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并进行实地专项核查。
(二) 保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	有权要求发行人按照证券发行上市保荐有关规定和保荐协议约定的方式，及时通报与保荐工作相关的信息；在持续督导期内，保荐人有充分理由确信发行人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，督促发行人作出说明并限期纠正，情节严重的，向中国证监会、上海证券交易所报告；按照中国证监会、上海证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明。
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	发行人协调相关当事人配合保荐机构的保荐工作，并督促其聘请的其他证券服务机构协助保荐机构做好保荐工作。
(四) 其他安排	无。

